

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-009

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于收到国家重点研发计划项目立项批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国科学技术部高技术研究发展中心下发的《关于国家重点研发计划“智能传感器”重点专项 2022 年度项目立项的通知》（国科高发计字【2022】59 号），公司作为牵头承担单位申报的“MEMS 传感器芯片先进封装测试平台”项目（项目编号：2022YFB3207100）获得立项批复，批复基本内容如下：

- 项目牵头承担单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司
- 项目负责人：刘胜
- 项目执行年限：2022 年 12 月至 2025 年 11 月
- 项目总经费人民币 12,500 万元，其中中央财政经费 5,000 万元
- 联合参与单位：武汉大学、华天科技（昆山）电子有限公司、中国科学院微电子研究所、中机生产力促进中心有限公司等
- 主要目标：针对高端 MEMS 传感器先进封装测试需求，以核心工艺建模仿真与验证为基础，突破一系列晶圆级键合、垂直互连、激光划片等共性关键技术；形成硅和玻璃通孔晶圆级、集成无源器件晶圆级、扇出型晶圆级、MEMS 与 ASIC 晶圆级集成、和高可靠性系统级封装等成套先进封装工艺；建立基于标准的面向图像传感器、硅麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台，面向行业开展服务。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2023年2月7日